

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 10 月 10 日 (2013.10.10)

【公開番号】特開 2012-146788 (P2012-146788A)
 【公開日】平成 24 年 8 月 2 日 (2012.8.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-030
 【出願番号】特願 2011-3331 (P2011-3331)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 1/14 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/14 H

H 0 5 K 1/14 G

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 8 月 23 日 (2013.8.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

2 面のうち少なくとも一方の面に半導体素子を実装される第 1 の基板と、

2 面のうち少なくとも一方の面に半導体素子を実装され、前記第 1 の基板に対向する第 2 の基板と、

基端が前記第 1 の基板に固定され、先端側が前記第 1 の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第 1 の接続端子板と、

基端が前記第 2 の基板に固定され、先端側が前記第 2 の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第 2 の接続端子板と、

前記第 1 の接続端子板の平面部と前記第 2 の接続端子板の平面部の少なくとも一方に形成したねじ挿通部を通して、前記第 1 の接続端子板の平面部と前記第 2 の接続端子板の平面部とが当接する状態で前記第 1 の接続端子板と前記第 2 の接続端子板を締結するためのねじ部材と、

を備えたことを特徴とする基板間接続構造。

【請求項 2】

前記第 1 の接続端子板と第 2 の接続端子板のうちの一方の接続端子板には前記ねじ部材が通るねじ挿通部が形成され、他方の接続端子板は前記ねじ部材が螺入するねじ孔を有し、

前記ねじ挿通部は、前記ねじ孔よりも大きいことを特徴とする請求項 1 に記載の基板間接続構造。

【請求項 3】

前記第 1 の接続端子板と第 2 の接続端子板の少なくとも一方は、前記第 1 の基板と第 2 の基板が接近する方向に変形して公差を吸収する公差吸収部を有することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の基板間接続構造。

【請求項 4】

前記公差吸収部は、接続端子板に切り欠きを形成することにより構成したことを特徴とする請求項 3 に記載の基板間接続構造。

【請求項 5】

前記第 1 の接続端子板は、前記基端から、前記第 2 の基板に対し接離する方向に延びる

第 1 の部位と、第 1 の部位の先端から前記第 1 の基板に対向する方向に延び前記平面部を構成する第 2 の部位を有し、

前記第 2 の接続端子板は、前記基端から、前記第 1 の基板に対し接離する方向に延びる第 1 の部位と、第 1 の部位の先端から前記第 2 の基板に対向する方向に延び前記平面部を構成する第 2 の部位を有することを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の基板間接続構造。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

請求項 1 に記載の発明では、2 面のうち少なくとも一方の面に半導体素子を実装される第 1 の基板と、2 面のうち少なくとも一方の面に半導体素子を実装され、前記第 1 の基板に対向する第 2 の基板と、基端が前記第 1 の基板に固定され、先端側が前記第 1 の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第 1 の接続端子板と、基端が前記第 2 の基板に固定され、先端側が前記第 2 の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第 2 の接続端子板と、前記第 1 の接続端子板の平面部と前記第 2 の接続端子板の平面部の少なくとも一方に形成したねじ挿通部を通して、前記第 1 の接続端子板の平面部と前記第 2 の接続端子板の平面部とが当接する状態で前記第 1 の接続端子板と前記第 2 の接続端子板を締結するためのねじ部材と、を備えたことを要旨とする。